

H3C 2016 年实习生招聘信息

[邀请函]

新 IT，迎未来。

站在互联网+的风口上顺势而为，我们要做新 IT 基础架构的领导者。

2014 年 H3C 助力巴西世界杯场馆无线建设；为 APEC 会议提供高可靠有线无线一体化网络；成为唯一通过云计算国家标准四项测试的厂商；成为腾讯唯一最佳服务供应商；在 2014 全球互联网技术大会上，获得 2014 年度互联网最佳合作伙伴奖；在第十届“中国·企业社会责任国际论坛”暨“2014 责任中国荣誉盛典”上，H3C 被授予“2014 最具责任感企业奖”，成为唯一一家获得该殊荣的 IT 企业。

2015 年 H3C 荣获“全国防火墙行业产品质量、服务质量用户满意品牌”。与中联重科联合举办主题为新 IT 新智造的智慧企业研讨会，推动传统制造业向数字化、智能化、网络化迈进。首次对外发布云计算产品融合架构 UIS2.0，实现了对 IT 基础架构系统的重新定义。首次进军消费类市场，发布消费类产品品牌魔法师 Magic 和新品 Magic B1。为苏州世乒赛提供有线无线网络保障和服务，是国际重大赛事的又一典型案例。CAS 虚拟化软件在 SPECvirt 测试中打破世界纪录，虚拟化性能业界最佳。获中国首批 OpenFlow v1.3 认证证书。华三云通过全部五项国家标准云测评，成为业界领先的通过全项测试的云计算厂商之一。华三无线应用于百行百业，引爆互联全场景时代，WiFi 支持乌镇世界互联网大会，安全天机首次发布....

2016 年，惠普与清华紫光携手打造的“新华三”将固本求变，以持续的技术创新和敏锐的市场洞察，创造更加卓越的新 IT 能力，打造新 IT 生态，促进行业变革及行业之间的跨界创新，推动中国信息化产业的发展。

过去的成就只代表过去，H3C 已经重新整装，朝着新的目标出发！

2016 年 H3C 研发实习生招聘已经启动，我们热忱欢迎各位优秀的同学加入！

[H3C 公司简介]

杭州华三通信技术有限公司（简称华三通信或 H3C），致力于 IT 基础架构产品及方案的研究、开发、生产、销售及服务，拥有完备的路由器、以太网交换机、无线、网络安全、服务器、存储、IT 管理系统、云管理平台等产品。华三通信在中国设有 38 个分支机构，目前公司有员工 5000 人，其中研发人员占 55%。

华三通信每年将销售额的 15% 以上用于研发投入，在中国的北京和杭州都设有研发机构，并设有可靠性试验室以及产品鉴定测试中心。截至 2014 年底，华三通信累计申请专利超过 5500 件，其中发明专利比例超过 90%。2014 年，华三通信发明专利授权量排名国内企业第十名。

在互联网大变革的时代，IT 的角色从传统的行业辅助工具变成革新的核心驱动力。传统 IT 的个性化架构支撑个性化应用的方式正在转变，华三通信提出了“新 IT 基础架构领导者”的愿景，用一种架构支撑面向用户的所有个性化应用，快速适应业务变化，实现动态平衡。以“云网融合”为技术战略，华三通信在移动互联、大数据、云计算、SDN、BYOD、智慧城市等关键领域持续创新，与应用合作伙伴深度融合，为用户提供整合、一体化的新 IT 方案。

根植中国，华三通信始终以“为客户创造价值”作为公司发展的源动力，不断细分客户需求。到 2014 年底，华三通信已服务于 70% 以上的中央部委、“十二金工程”中的九个全国骨干网，四大国有商业银行，500 强企业中的 400 家，全部“211”高校和“985”高校，并规模服务于电信、移动、联通、广电等运营商市场。

在全球市场，华三通信研发和生产的产品服务近百个国家和地区，客户包括惠普、梦工厂、瑞士电信、西班牙电信、英国沃达丰、法国国铁、法国标致雪铁龙集团、俄罗斯联邦储蓄银行、澳大利亚昆士兰政府、美国麻省理工学院、韩国三星电子、AMD、时代华纳、美国太平洋人寿保险等。

更多信息请访问公司网站：<http://www.h3c.com>

[实习生招聘流程]

1、如有实习意向，请填写《H3C 实习生报名表》电子件发送到 wangnan.07770@h3c.com



H3C公司实习生报名表(2016年).doc

由于简历较多，不一一回复，请设置请求邮件阅读回执。

2、后续将安排到学校举行宣讲会/笔试/面试，请携带个人简历和《H3C 实习生报名表》（纸件）参加 H3C 实习生宣讲会。（宣讲会安排请注意后续学校老师通知）

3、面试通过后组织同学签署三方实习协议。后续根据同学课程结束时间安排实习报到。

[2016 年 H3C 实习生招聘岗位及要求]

H3C 自 2004 年启动实习生计划以来，和国内多所 985、211 高校进行实习生培养合作，形成一套成熟的实习生培养计划和管理规范。公司拥有成熟的实习平台、规范的实习生管理和丰富的实习生活体验，欢迎各位优秀的同学加入！

2016 年实习生招聘岗位如下：

以下岗位要求实习时间 10 个月以上（公司可提供毕设课题）。

1、软件开发类工程师（实习）

实习地点：北京/杭州

学历及专业要求：硕士在读一年级、通信、电子、计算机、软件等对口专业。

素质要求：上进心强，团队合作意识强，主动性好，思路开阔，沟通能力强，擅长逆向思维。

专业技能：

- 1) 至少熟练掌握下面开发语言的一种：Java、C/C++、数据库，掌握操作系统、数据结构等相关知识，理解计算机通信的主要原理；
- 2) 对嵌入式操作系统、数据通信、信息安全等方面有技术专长的优先考虑；
- 3) 具有项目开发实践经验者优先考虑。

2、软件测试类工程师（实习）

实习地点：北京/杭州

学历及专业要求：硕士在读一年级、通信、电子、计算机、软件等对口专业。

素质要求：上进心强，团队合作意识强，主动性好，思路开阔，沟通能力强，擅长逆向思维。

专业技能：

- 1) 至少熟练掌握下面开发语言的一种：**Java、C/C++、数据库**，掌握操作系统、数据结构等相关知识，理解计算机通信的主要原理；
- 2) 对嵌入式操作系统、数据通信、信息安全等方面有技术专长的优先考虑；
- 3) 具有测试经验及自动化测试工具知识者优先考虑。

3、硬件测试工程师（实习）

实习地点：杭州

职位招聘对象：具备连续从事 10 个月实习时间的在校研究生同学

实习工作内容：

- 1)分析和解决各类硬件问题；
- 2)硬件设计审查和硬件测试。

素质要求：

- 1)主动性强，学习能力强；
- 2)肯吃苦，有钻研精神；
- 3)具备良好的沟通能力和团队合作意识。

专业技能：

- 1) 计算机、通信及控制、自动化等专业。
- 2)掌握高频电子线路、低频电子线路，数字电路等相关知识；
- 3)有电子设计、单板开发调试、测试、问题解决经验者优先。

4、硬件开发工程师（实习）

实习地点：杭州

职位招聘对象：具备连续从事 10 个月实习时间的在校研究生同学

实习工作内容：

- 1)分析硬件方案和器件资料；

2) 硬件设计和调试。

素质要求:

- 1) 主动性强，学习能力强；
- 2) 肯吃苦，有钻研精神；
- 3) 具备良好的沟通能力和团队合作意识。

专业技能:

- 1) 计算机、通信及控制、自动化等专业。
- 2) 掌握高频电子线路、低频电子线路，数字电路等相关知识；
- 3) 有电子设计、单板开发调试、测试、问题解决经验者优先。